

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

令和8年6月25日

国立大学法人横浜国立大学長 梅原 出

◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 14

○第2号

1 調達内容

- (1) 品目分類番号 24
- (2) 導入計画物品及び数量 レーザー剥離装置一式
- (3) 調達方法 購入等
- (4) 導入予定時期 令和10年2月
- (5) 調達に必要とされる基本的な要求要件

φ12インチの接合ウエハに対し、剥離および洗浄を行う機能を有すること。

1ブロック内に2つ以上の洗浄モジュールを備え、剥離後のトップウエハおよびボトムウエハを同時に洗浄可能であること。

2 資料及びコメントの提供方法 上記1(2)の物品に関する一般的な参考資料及び同(5)の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

- (1) 資料等の提供期限 令和8年7月28日17時00分(郵送の場合は必着のこと。)
- (2) 提供先 〒240-8501 横浜市保土ヶ谷区常盤台79-1 国立大学法人横浜国立大学財務部 経理課契約第一係 杉山 恵梨子 電話 045-339-3241

3 説明書の交付 本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

- (1) 交付期間 令和8年6月25日から令和8年7月28日まで。
- (2) 交付場所 上記2(2)に同じ。

4 説明会の開催 本公表に基づく導入説明会を開催する。

- (1) 開催日時 令和8年7月7日10時30分
- (2) 開催場所 横浜国立大学本部棟3階事務局 第2会議室
- (3) 留意事項 説明会への参加を希望する者は上記2(2)へ令和8年7月6日17時までに連絡すること。

5 その他 この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

5 Summary

- (1) Classification of the products to be procured : 24
- (2) Nature and quantity of the products to be purchased: Laser release system 1 Set
- (3) Type of the procurement : Purchase
- (4) Basic requirements of the procurement :
The system shall be capable of performing debonding and cleaning of bonded φ12 inch wafers.
The processing section shall be equipped with two or more cleaning modules, enabling simultaneous cleaning of both top and bottom wafers after debonding.
- (5) Time limit for the submission of the requested material : 17:00 28 July, 2026
- (6) Contact point for the notice :SUGIYAMA Eriko, Accounting and Contract Division, Finance Department,National University Corporation Yokohama National University, 79-1 Tokiwadai Hodogaya-ku Yokohama-shi 240-8501 Japan, TEL 045-339-3241